

科技部工程司公開徵求107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」

計畫申請注意事項:

- 一、本計畫申請人依本部補助專題研究計畫作業要點，研提計畫申請書(採線上申請)；**申請人之任職機構應於106年11月20日(週一)前備函送達本部**(請彙整造冊後專案函送，逾期恕不受理)。
- 二、本計畫規劃將整合學界研發能量與資源，鼓勵學術團隊參與，並與產業共同合作，建立關鍵自主技術及增加附加價值。
- 三、計畫之研究主題必須具有前瞻性、關鍵性及創新性，計畫內容必須陳述國內外現狀及所欲達成之技術指標，同時，必須陳述四年計畫規劃藍圖(roadmap)及執行內容，並具體說明階段性成果與後續產業化成效。
- 四、本部對執行計畫每年進行審查，執行團隊必須定期提報計畫執行進度與成果，並出席各項審查會議，各執行團隊須能展示該計畫所開發之技術或系統成果。
- 五、本計畫徵求公告相關內容如附檔。
- 六、本計畫說明會，場次及時間地點如下列，敬請就近參加，並請先報名，網址如下：

<https://goo.gl/8JkhV2>

1.北部說明會

時間：106年9月13日(三)上午9時30分

地點：科技部(科技大樓)1樓(簡報室)

2.中部說明會

時間：106年9月13日(三)下午3時整

地點：中興大學 電機大樓4樓407會議室

3.北部說明會

時間：106年9月15日(五)上午10時30分

地點：清華大學 台達館5樓525室

4.南部說明會

時間：106年9月19日(二)上午10時整

地點：成功大學電機系館 1樓靄雲廳